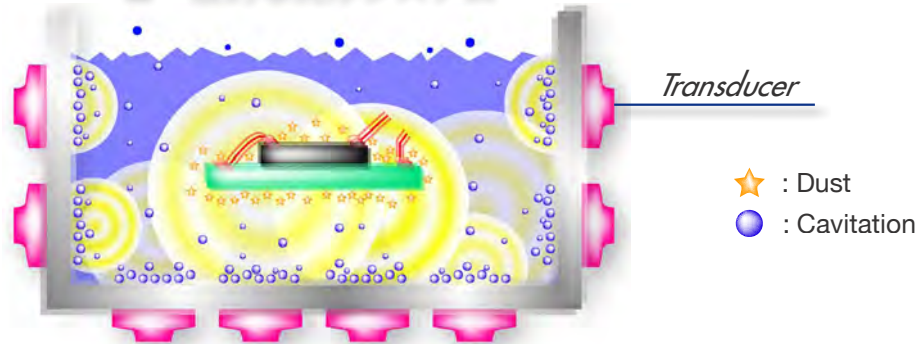


technical information

〈Sound Soldering & Cleaning Tech. for IC package〉

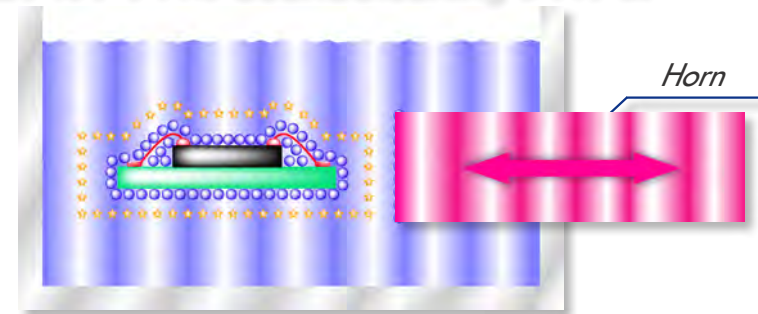
アルテックスの[サウンドソルダーリング]と[サウンドクリーニング]技術は同じ理論です

■一般的な洗浄システム



複数の振動子がタンクの外部にボンドで貼り付けてある。全ての振動子の固有周波数が異なるので全体が共振できず衝撃波の慣性が発生しパーツがダメージを受ける。

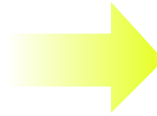
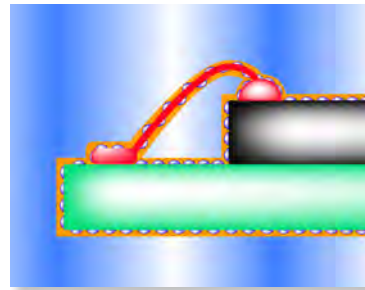
■アルテックスの SoundCleaning システム



1本のホーンだけが外部からタンク内に挿入されている。パーツも含めて全体が一つの共振周波数で同調するのでパーツへのダメージが発生しない。(デジトラックチューニング)

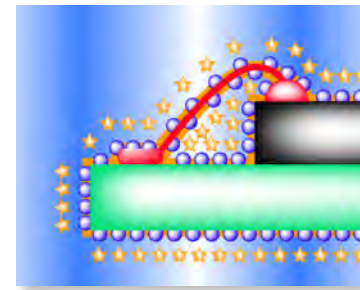
〈Step.1〉

純水を通じてホーンとパーツが共振する。ホーンとパーツの両面からキャビテーションが発生することでダストが遊離される。



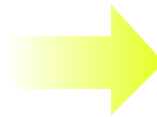
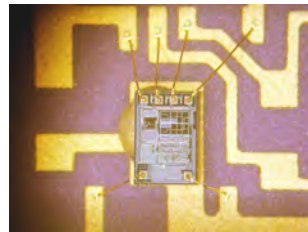
〈Step.2〉

パーツ自身の表面から発生したキャビテーションがダストを完全に取り去る。

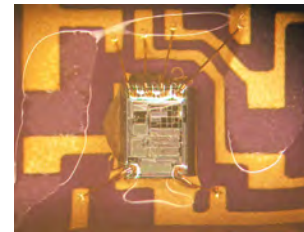


洗浄前

[洗浄条件]
洗浄液：水道水
周波数：20kHz
振動振幅：5um
洗浄時間：10sec.



洗浄後



IC パッケージ

慣性が発生しないのでワイヤーボンディングにダメージがない。

ULTEX
SoundPower Laboratory